

History of Intel

インテルのあゆみ

インテルは、シリコンバレーの由来となったシリコン(半導体)をこの地で開花させた企業であり、インテルのテクノロジーは、私たちの生活に感動体験や変革をもたらすイノベーションの源泉です。

インテルは、IT 業界を代表する企業であり、世界の進歩を支え、私たちの生活を豊かにする革新的なテクノロジーを創造しています。今日、人工知能(AI)、5G ネットワーク変革、インテリジェント・エッジなど、業界の転換点となる技術が台頭していますが、インテルのシリコン / ソフトウェア技術はこの変化を加速させる、中核的な役割も担っています。

このような革新的なテクノロジーの活用が進み、新しいテクノロジーを生かしたさまざまなコンピューティング機器の増大により、膨大な量のデータが日々、生成され、データは私たちの生活やビジネスの変革を生み出す力となりました。そして、小売店や病院、工場、さらには自動車も“データの工場”と呼ばれるようになりました。コンピューティング処理の対象があらゆる施設やモノへと広がる今、データの移動・保存・処理を一層、高速・安全に実行することが急務であり、インテルはこのような時代のニーズの実現に努めています。インテルは、テクノロジーの信頼性とパフォーマンスに優れたリーダー企業として、生活者、企業・団体、社会がデータのもつ価値を世界規模で活用できるよう、データの可能性を切り拓いています。

会社概要

インテル株式会社

商号:	インテル株式会社
本店所在地:	東京都千代田区丸の内3丁目1番1号
設立:	1976年4月28日
株主:	インテル コーポレーション
代表取締役社長:	鈴木 国正
事業所:	東京本社 (東京都千代田区丸の内3-1-1 国際ビル5階) など

Intel Corporation (インテル コーポレーション)

会社名:	Intel Corporation
設立:	1968年7月18日
設立者:	ロバート・N・ノイス(故人) ゴードン・E・ムーア (インテル コーポレーション 名誉会長)
代表者:	ボブ・スワン (インテル コーポレーション CEO)
本社:	米国カリフォルニア州サンタクララ(本社)



インテルのパーパス（存在意義）

～ 世界を変革するテクノロジーを生み出し、
地球上のあらゆる人々の生活を豊かにするために ～

インテルは明瞭なパーパス（存在意義）を社員、ステークホルダーと共有することにより、常に革新的なテクノロジーを創造し、新しい可能性を切り拓いてきました。インテルは50年以上前から3つの取り組みに注力し、今日においても社会に大きな影響を与える貢献を果たしています。

- 私たちの生活に変革をもたらす製品 / テクノロジー・イノベーションの普及促進
- 事業の特長と規模を生かしながら、パートナーとともにより良いビジネス、社会、地球の実現に貢献
- 自社ならびに業界全体としての社会的責任、持続可能性、ダイバーシティー & インクルージョンの推進

イノベーションを推進

インテルには、“6つのイノベーションの柱”があります。
この“6つの柱”が、データの価値を引き出す
画期的な製品を生み出します。



顧客へのコミットメント

研究開発・設備投資のグローバルリーダーとして、顧客の成果を数量化・可視化し、
拡大させる最高品質の製品を提供します。

2019年の投資実績
134億ドル
の投資に基づく研究開発力

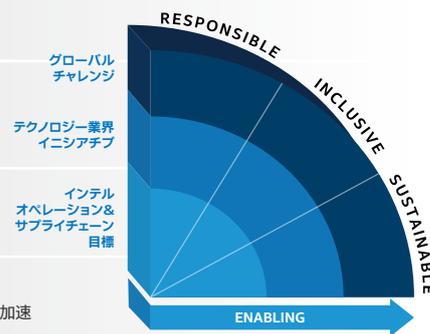
2019年の投資実績
162億ドル
に上る設備投資への注力

最先端を極める先進の
プロセッサ・テクノロジー

グローバルインパクトへの貢献



RESPONSIBLE (社会的責任)	テクノロジーを活用した健康 / 安全面での変革
INCLUSIVE (受容性)	テクノロジー業界での完全なインクルージョン (多様な人材が平等に受容される環境) の実現、デジタルレディネス (デジタル化への対応力) の強化
SUSTAINABLE (持続可能性)	気候変動に対応するためのカーボン・ニュートラル・コンピューティングの実現
ENABLING (実現能力)	インテルのテクノロジーと世界中の社員の有するノウハウと情熱を結集させ、目標達成に向けた取り組みを加速

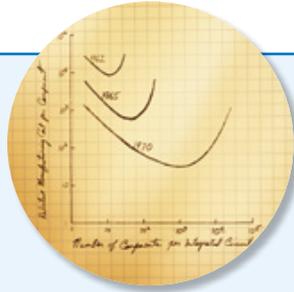


History of Intel

インテルの歴史

1965年4月

当時、フェアチャイルド・セミコンダクター社に在籍していたゴードン・ムーアが、後に“ムーアの法則”として知られる半導体技術の進歩に関する予測を発表。「トランジスターの集積度は約2年で倍増する」とし、半導体業界の技術革新の指針となる。



1968年7月18日

ロバート・ノイスとゴードン・ムーアが、米国カリフォルニア州マウンテンビューにインテル コーポレーション (当時の社名は NM Electronics) を設立。その語源は、INTEgrated ELectronics (集積されたエレクトロニクス)。アンドリュウ・グループが、設立後まもなく入社。インテルは、集積回路の研究、開発、製造、および販売を事業の主軸とする。当時主流であった磁気コアメモリに代わる半導体メモリ製品を主要製品として開発。



1970年4月

インテル初の自社キャンパス用地として、米カリフォルニア州サンタクララに26エーカー(約10万5,000平方メートル)の土地を購入。翌年、インテル初の自社ビルと「ファブ2」を開設。

1970年10月

世界初の商用 DRAM 製品 1103 を発表。記憶容量は1,024ビット。

1971年9月

世界初の EPROM、1702 を製品化。記憶容量は2,048ビット。

1971年10月

東京・渋谷区に、インテル・ジャパン・コーポレーション日本支社(インテル株式会社の前身)を設立。

NASDAQ 市場で株式を公開。初値は23ドル50セントで680万ドルを調達。

1968年7月 (~1975年)

ロバート・ノイスが初代社長兼 CEO (最高経営責任者) に就任。



1968年

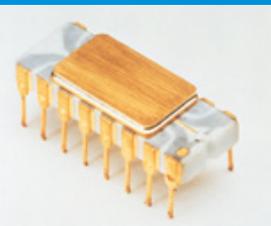
米カリフォルニア州マウンテンビューの古い工場を借り、インテル最初の製造施設を開設。

1969年4月

インテル製品第1号となるメモリー製品、ショットキー・バイポーラー RAM3101 を発表。記憶容量は64ビット。

Two Found New Firm

MOUNTAIN VIEW — Two founders of Fairchild Semiconductor Division here who resigned last month have established a new integrated circuits electronics company. The firm, Intel Corp., has leased part of a building at 485 Middlefield Rd. formerly occupied by Union Carbide Corp.'s integrated circuit division. Most of the firm's staff is being moved to San Diego. Founders of Intel Corp. are Dr. Robert W. Noyce and Gordon Moore. Both were among eight who started Fairchild Semiconductor here more than 10 years ago and helped build it into the world's largest producer of integrated circuits. They quit last month from Fairchild Camera & Instrument Corp., parent of the Mountain View division. The firm has experienced slipping profits recently, but Noyce and Moore said they resigned to regain the satisfaction of research and development in a small, growing company.



4004 マイクロプロセッサ(1971年11月)

1971年11月

Electronics News 誌の広告で、世界で初めてのマイクロプロセッサ 4004 を発表。幅は約3mm、長さは約4mmで、2,300個のMOS型トランジスターを搭載。108KHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は10ミクロン。

1968年7月

はじめは、
わずか1枚の事業企画書

ロバート・ノイスとゴードン・ムーアはベンチャー・キャピタリストのアーサー・ロック氏の支援によってインテルを創業。ロック氏は、ノイスとムーアがまとめた、わずか1枚の事業企画書で250万ドルの資金を調達。



1972年4月

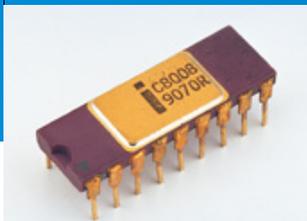
8ビットのマイクロプロセッサ 8008を発表。3,500個のトランジスタを搭載し、200KHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は10ミクロン。

1972年6月

コンピューター・チップの製造を50ミリ・ウエハーから75ミリ・ウエハーに移行。

1972年11月

マレーシア・ペナンに海外初の半導体組立て・テスト(後工程)施設「A1」を竣工。



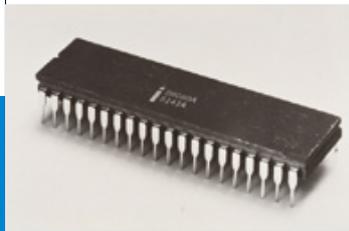
8008 マイクロプロセッサ(1972年4月)

1974年4月

8ビットのマイクロプロセッサ 8080を発表。6,000個のトランジスタを搭載し、2MHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は6ミクロン。

1974年7月

イスラエル・ハイファにデザインセンターを開設。



8080 マイクロプロセッサ(1974年4月)

1976年3月

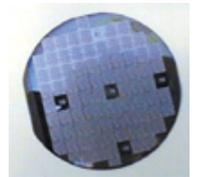
8ビットのマイクロプロセッサ 8085を発表。6,500個のトランジスタを搭載し、2MHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は3ミクロン。

1976年4月

東京・世田谷区に、インテルジャパン株式会社(現インテル株式会社)を設立。

1976年6月

100ミリ・ウエハーでの製造を開始。



8085 マイクロプロセッサ(1976年3月)



1973年4月

クリーンルームでバニースーツ(防塵服)の着用開始。

1975年4月 (~1987年)

ゴードン・ムーアが第2代CEOに就任。1990年には、ジョージ・ブッシュ米国大統領(当時)よりナショナル・メダル・オブ・テクノロジーを受賞。1997年、名誉会長に就任。



1974年

企業文化“Six Values”のルーツ

インテルの企業文化“Six Values”の起源は、1974年の“Eleven Values”に遡る。現在も継承されているDiscipline、Risk Taking、Result Orientationに加え、Openness(オープン)やProblem Solving(問題解決)など当時の経営哲学が今なお、脈々と息衝いている。今あるQualityとCustomer Orientationは、日本企業の優れた製造管理に学んだもの。

Intel Six Values

- Customer Orientation
- Discipline
- Great Place to Work
- Quality
- Result Orientation
- Risk Taking

1979年5月

Fortune 500に486位で初登場。

1979年6月

16ビットのマイクロプロセッサ8088を発表。1981年に、IBM PCおよびIBM互換機で採用されることにより、現在の事業の礎を築く。

1Mビットのバブルメモリー製品を発表。

1979年10月

米オレゴン州ヒルズボロに製造拠点を開設。

1979年11月

ロバート・ノイスが、ジミー・カーター米国大統領(当時) からナショナル・メダル・オブ・サイエンスを受賞。



1981年1月

米ニューメキシコ州リオ・ランチョに「ファブ7」を開設。

1981年8月

IBMがインテルの8088マイクロプロセッサを採用し、同社初のパソコンを発表。

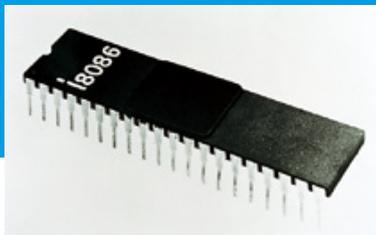
1981年11月

イスラエル・エルサレムに「ファブ8」を開設。

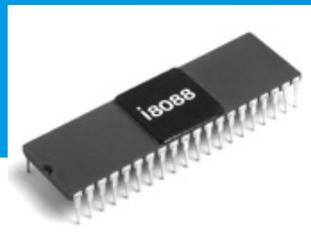
1981年

社内で優れた功績を残した人物を表彰する「インテル アchievement・アワード」を開設。

つくばに自社ビルを設立。



8086 マイクロプロセッサ(1978年6月)



8088 マイクロプロセッサ(1979年6月)

1978年6月

16ビットのマイクロプロセッサ8086を発表。2万9,000個のトランジスタを搭載し、5~10MHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は3ミクロン。

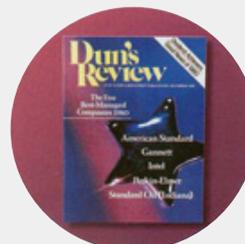
1980年5月

ゼロックス、デジタルイクイップメント(DEC)とともに、ローカル・エリア・ネットワーク(LAN)規格であるイーサネットの開発を開始。その後、イーサネットは企業内ネットワークの標準規格として広く普及。

1980年12月

CSRやコーポレート・ガバナンスの先進企業

Dun's Review誌で経営力に優れた企業上位5社の1社に選ばれる。1984年にはThe 100 Best Companies to Work for in America、ならびにFortune誌のmaster of innovationの1社に選出。また、2008年にはダウ・ジョーンズ・サステナビリティ・インデックス(DJSI)の構成銘柄に10年連続採用となり、「サステナビリティに配慮して事業を推進する世界の先進企業の1社」と評価される。



1982年2月

16ビットの高性能マイクロプロセッサ80286を発表。13万4,000個のトランジスタを搭載し、6～12.5MHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は1.5ミクロン。

1983年12月

150ミリ・ウエハーでの製造を開始。



1987年4月 (～1998年)

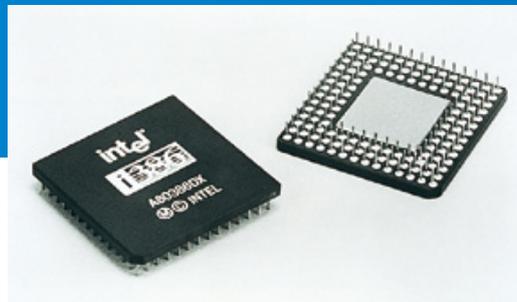
アンドリュー・グローブが第3代CEOに就任。1997年には、「情報革命を最前線で推進する」、「インテルをシリコンバレーの力の源泉に育て上げた」として、米タイム誌の「Man of the Year」に選出される。2005年5月、上席顧問に就任し、現在に至る。

1987年10月

米オレゴン州アロハに開発ファブ「D1」を開設。



80286マイクロプロセッサ(1982年2月)



Intel386™マイクロプロセッサ(1985年10月)

1985年10月

ビジネス史に残る経営判断

当時、社長兼COO(最高執行責任者)だったアンディ・グローブは後年、DRAM事業からの撤退を次のように回想している。「私は、CEOだったゴードン・ムーアとともに、「新しい経営陣だったらどのように判断するだろうか?」という視点でDRAM事業の将来を議論しました。結果、マイクロプロセッサ事業にフォーカスすると決定しました。私のこれまでのキャリアで、DRAM事業の撤退ほど奏功した経営判断はなく、インテルだけでなく、業界にとっても良い決断だったと確信しています。数あるメモリーメーカーの中の1社として事業を継続していたとしても、業界に貢献できることはほとんどなかったでしょう。マイクロプロセッサの開発と生産に躊躇なく経営資源を集中することで、パソコン業界の技術のけん引役を担うことができました」

1985年2月

複数の80286マイクロプロセッサを搭載したiPSC/1を発表し、並列型スーパーコンピューティング事業に参入。

1985年10月

インテル創業以来初めての戦略転換点(Strategic Inflection Point)として、DRAM事業からの撤退を決断。経営資源をMPU事業に集中。

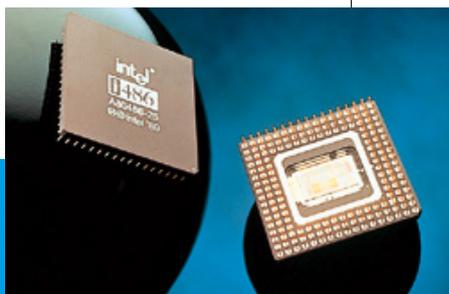
Intel386™マイクロプロセッサを発表。27万5,000個のトランジスタを搭載し、16～33MHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は1.5～1ミクロン。32ビット・データ・セットを扱う初のx86チップ。

1988年6月

災害支援や学生の教育支援など、さまざまな社会貢献活動を目的としたインテル基金を設立。

1988年11月

EPRMトンネル酸化(ETOX)技術を用いて、フラッシュメモリー事業に参入。



Intel486™ マイクロプロセッサ(1989年4月)

1989年2月

100万個のトランジスタを集積した業界初の商用マイクロプロセッサ i860 プロセッサを発表。

1989年4月

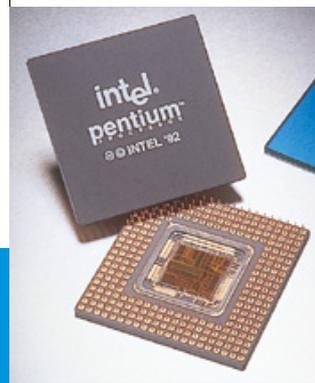
Intel486™ マイクロプロセッサを発表。120万個のトランジスタを搭載し、16～100MHzのクロック周波数で動作。プロセス技術は1～0.6ミクロン。

1993年1月

米ガートナー社による1992年の世界半導体売上高ランキングで、インテルは世界最大の半導体メーカーとなる。

1993年3月

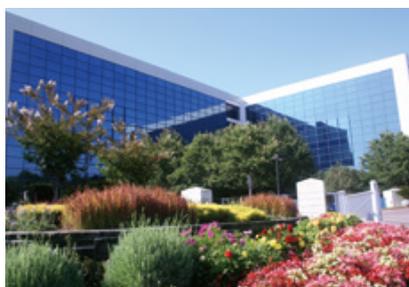
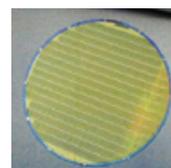
スーパースケーラー・アーキテクチャーを採用した第5世代製品、インテル® Pentium® プロセッサを発表。クロック周波数は60～300MHz。プロセス技術は0.8～0.35ミクロン。1997年1月には、ビデオやオーディオ、グラフィックス・データを効率的に処理する命令セットを付加した、インテル® MMX® テクノロジー Pentium® プロセッサを追加。



インテル® Pentium® プロセッサ(1993年3月)

1992年4月

200ミリ・ウエハーでの製造を開始。



1991年5月

消費者がインテルのプロセッサを搭載したパソコンを簡単に認識できるようにと、Intel Inside® ロゴを発表。Intel Inside® ロゴは、インテルのプロセッサのシンボルとして、また、インテルの先進技術と安全性、信頼性を表すものとして、世界中で知られるようになる。

1991年12月

本会社屋、ロバート・ノイス・ビルディングが竣工(写真は現在の様子)。

1991年5月

認知度抜群!“インテルはいつてる”

消費者がインテルのプロセッサを搭載したパソコンを簡単に認識できるようにと、Intel Inside® ロゴを発表。このロゴの入った初めての広告は、IBMが1991年4月にウォール・ストリート・ジャーナル紙に掲載。10年後

には、世界中で2,700社のコンピューター・メーカーにこのロゴが採用され、また、Intel Inside®のサウンドロゴもテレビやラジオを通じて、世界中のどこかで5分に1回の割合で流れるようになる。





1994年1月

遠隔地のパソコンユーザー同士が、お互いの顔を見て会話をしながら、ドキュメントの共有を行えるインテル ProShare[®] ビデオ会議システムを発表。



1994年12月

アイルランド・レイクスリップに「ファブ 10」を開設。



1996年

数千人の社員の参加による地域貢献のボランティア活動「インテル インポルブド・プログラム」発足。

1996年7月

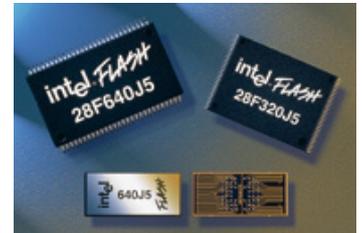
インテルのウェブサイトに、インターネット電話用ソフトウェアを掲載し話題になる。ユーザーは無償でダウンロードして利用。

1997年5月

P6 マイクロアーキテクチャーの先進技術に、インテルのマルチメディア機能を強化する MMX[®] テクノロジーを統合した、インテル[®] Pentium[®] II プロセッサを発表。クロック周波数は 233 ~ 450MHz。プロセス技術は 0.35 ~ 0.18 ミクロン。

1997年9月

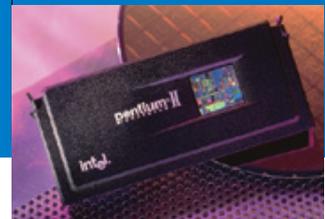
1つのメモリーセルに1ビットではなく、2ビットの情報を記憶することができる Intel StrataFlash[®] メモリーを発表。



インテル[®] Pentium[®] Pro プロセッサ
(1995年11月)



インテル[®] MMX[®] テクノロジー
Pentium[®] プロセッサ
(1997年1月)



インテル[®] Pentium[®] II プロセッサ
(1997年5月)

1995年8月

コンパック、DEC、IBM PCカンパニー、マイクロソフト、NEC、ノーザンテレコムとともに、パソコンとキーボードやモデムなど、外部周辺機器を接続するための新規格、USB (ユニバーサル・シリアル・バス) に準拠した製品開発を推進する業界標準団体を発足。

1995年11月

ダイナミック・エグゼキューション技術を採用した第6世代製品、インテル[®] Pentium[®] Pro プロセッサを発表。クロック周波数は 150 ~ 200MHz。プロセス技術は 0.6 ~ 0.35 ミクロン。

1998年4月

“ブルービジネス”対“グリーンビジネス”

当時、CEOだったクレイグ・バレットが、業界ならびに自社の将来の成長に向け、マイクロプロセッサ事業の進展に加え、新規事業の開拓を目指す。この新規事業は、中核事業のマイクロプロセッサの“ブルービジネス”に対して、“グリーンビジネス”と命名される。戦略投資、研究開発、製造部門ほかの経営幹部が集まり、主にインターネット

関連や民生機器向けの有望な技術の発掘、コンセプト策定、事業調査、事業化に取り組む。顕著な成果として、次世代高速無線通信 WiMAX* 事業や、高性能コンピューティング (HPC) 向けに 50 個の演算コアを集積するメニーコア・プロセッサの Knights Corner (開発コード名) などが挙げられる。

1999年2月

インテル® Pentium® III プロセッサを発表。インターネット・ストリーミングSIMD 拡張命令を搭載し、ストリーミング・オーディオ、ビデオなどのアプリケーションの処理性能を飛躍的に向上。クロック周波数は450MHz ~ 1.40GHz。プロセス技術は250 ~ 130nm。

1999年

イスラエル・キリヤットガットに製造施設「ファブ18」を開設。

2000年11月

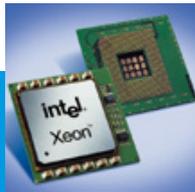
デスクトップPC向けに「インテル® Pentium® 4 プロセッサ」を発表。プロセス技術は180 ~ 65nm。クロック周波数は1.40 ~ 3.80GHz。



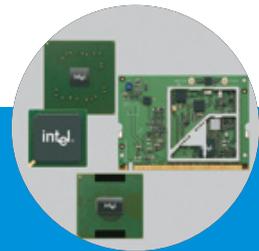
インテル® Pentium® III プロセッサ
(1999年2月)



インテル® Pentium® 4 プロセッサ
(2000年11月)



インテル® Xeon® プロセッサ
(2001年5月)



インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー (2003年3月)

2002年2月

300ミリ・ウエハーでの製造を開始。

2002年9月

現在主流のプレーナー(平面)型トランジスタより電力効率に優れ、かつ高い性能を実現する、革新的な3次元構造の「トライゲート・トランジスタ」を開発。非プレーナー型3次元構造トランジスタの時代の到来を予見。

2003年3月

ワイヤレス機能、長いバッテリー駆動時間、薄型軽量のフォームファクター、卓越したモバイル性能を実現するノートブックPC向けの「インテル® Centrino® モバイル・テクノロジー」を発表。なお、「Centrino®」は現在、無線製品のブランド名として使用されている。

2003年6月

家電、コンピューター、モバイル業界の17企業が協力し、非営利団体であるデジタル・リビング・ネットワーク・アライアンス(2004年6月に改称)を設立。家電・PC・モバイルなどの機器間での、音楽・写真・ビデオなどのデジタルコンテンツの簡単な共有を目指す。

1998年4月

バリューPCセグメント向けプロセッサのインテル® Celeron® プロセッサを発表。クロック周波数は266MHz ~ 3.46GHz。プロセス技術は250 ~ 45nm(ナノメートル)。

1998年5月 (~2005年)

クレイグ・バレットが第4代CEOに就任。米国半導体工業会やセマテック(半導体製造技術研究所)の取締役も務める。



1998年12月

米国エネルギー省管轄下のサンディア国立研究所が主導する、衛星、宇宙船、防衛システム向けのインテル® Pentium® プロセッサの開発を支援。

2001年5月

サーバー/ワークステーション向けの「インテル® Xeon® プロセッサ」を発表。クロック周波数は1.40 ~ 3.80GHz。プロセス技術は180 ~ 45nm。

2001年5月

エンタープライズ・コンピューティング向けにインテル初の64ビット・プロセッサとなるインテル® Itanium® プロセッサを発表。広範囲な業界エコシステムを形成しながら、企業のミッション・クリティカル・コンピューティングのニーズに対応。クロック周波数は733MHz ~ 1.66GHz。プロセス技術は180 ~ 90nm。

2005年4月

インテル初のデュアルコア・プロセッサ製品となるインテル® Pentium® プロセッサ エクストリーム・エディション 840 を発表。

2005年5月 (~2013年)

ポール・オッテリーニが第5代CEOに就任。インテルをモバイル・テクノロジーやデジタルホーム、デジタル・エンタープライズなど、消費者や企業ユーザーの利用形態に即したプラットフォームを提供する企業へと転換を図る。



2005年11月

マイクロン・テクノロジー社と共同で「IMフラッシュ・テクノロジーズ社」を設立し、家電機器や携帯通信端末などに利用されるNAND型フラッシュメモリー事業に参入。

2006年1月

コーポレート・ロゴと製品ロゴを刷新。コンピューティングのプラットフォーム技術を提供する企業として、新生インテルを訴求。



2006年7月

高い性能と優れた電力効率を両立させる先進のインテル® Core™ マイクロアーキテクチャーを採用した「インテル® Core™2 Duo プロセッサー」を発表。クロック周波数は1.06～3.20GHz。プロセス技術は65～45nm。これに先立つ6月にはサーバー向けに「インテル® Xeon® プロセッサー 5100 番台」を発表。

2006年9月

コア間や複数のコアとメモリー間で、テラバイト級の高速データ転送を可能にするテラフロップ・プロセッサーの研究用チップを発表。80個のシンプルなコアを搭載し、3.10GHzで動作。プログラム可能なテラフロップ・プロセッサーとしては世界初。

2007年6月

コンピューター・メーカーや環境団体、電力会社、小売企業、政府機関ほか、数十の企業や団体とともに「クライメート・セイバーズ・コンピューティング・イニシアチブ」を設立。新しい環境問題への広範な取り組みを通じて、電力効率に優れたコンピューティング利用を推進。

2007年9月

KDDI、東日本旅客鉄道(JR 東日本)、京セラ、大和証券グループ本社、三菱東京UFJ銀行とともに、モバイルWiMAX* 技術を用いた2.5GHz 広帯域移動無線アクセスシステムの特定期間開設計画の認定取得を目的に設立した「ワイヤレスブロードバンド企画株式会社(現:UQコミュニケーションズ株式会社)」を設立。同年12月に総務省が免許を交付。

2007年11月

半導体業界40年のなかで最大の変革となるハフニウムベースのHigh-k(高誘電率)材料とメタルゲートを初めて採用したトランジスターに基づいた45nm プロセス技術採用のプロセッサーを発表。従来製品比最大38%の電力効率の向上を実現させる一方、環境に負荷を与える鉛を完全に排除した環境に優しいプロセッサー。サーバー向けおよびハイエンドPC向けに続き、2008年1月にメインストリームPC向け製品を出荷。



インテル® Core™2 Duo プロセッサー
(2006年7月)



インテル® Core™2 Extreme プロセッサー
(2006年11月)



インテル® Core™2 Quad プロセッサー
(2007年1月)



インテル® Core™ i7 プロセッサー
(2008年11月)

2006年10月

企業PC向けのプラットフォーム技術「インテル® vPro® テクノロジー」を発表。ソフトウェア企業やITサービス企業、PCメーカーのサポート部門などとの協力を通じて、セキュリティ対策やTCOの削減、変化するワークスタイルなど、IT部門が抱えるさまざまな課題解決を目指す。

2006年11月

クアッドコア(4つのコアを内蔵)プロセッサーを出荷開始。ゲーム愛好家やコンテンツ・クリエイターを対象にした「インテル® Core™2 Extreme プロセッサー QX6700」とデュアル・プロセッサー・サーバー用途の「インテル® Xeon® プロセッサー 5300 番台」を投入。メインストリームPC向けのクアッドコア製品「インテル® Core™2 Quad プロセッサー」は2007年1月に出荷開始。

2007年3月

中国北東部の遼寧省大連市に300ミリ・ウエハー対応の半導体量産製造施設(ファブ68)を建設する計画を発表。2010年10月、アジアでインテル初の半導体製造施設として竣工。

2007年5月

企業ユーザーをターゲットとした新しいノートブックPC向け技術「インテル® Centrino® Pro プロセッサー・テクノロジー」を発表。インテル® vPro® テクノロジーの優れたセキュリティ、管理機能、信頼性をノートブックPCで実現。

2008年4月

インテルの歴史において最小かつ最も低い消費電力で動作するプロセッサー、Intel Atom® プロセッサーを発表。

2008年11月

高性能デスクトップPC向けに新しく開発された先進のNehalem(開発コード名)マイクロアーキテクチャーを採用した「インテル® Core™ i7 プロセッサー」を発表。

2008年12月

会社設立40周年を記念して、2008年を通じて実施された社会貢献活動の時間数が100万時間に到達。世界40カ国以上、4万7,000人の社員が参加し、学校、地域支援組織、非営利団体など、約5,500の施設で社会貢献活動に取り組む。

2009年12月

業界で初めて、32nm プロセス技術を採用したマイクロプロセッサの出荷を開始。第2世代のHigh-kメタルゲート・トランジスターを搭載し、性能、電力効率が向上。

2010年8月

さらなる事業拡大に向け、インフィニオンの無線ソリューション事業とマカフィーを買収。インテルが将来に向け注力するインターネット接続とセキュリティの2つの技術を強化。

2010年10月

米国の製造拠点での次世代22nm プロセス製造技術の展開に向け、60～80億ドル規模の投資を発表。オレゴン州に新たな半導体製造施設(ファブ)「D1X」を新設、またアリゾナ州(ファブ12、ファブ32)およびオレゴン州(D1C、D1D)、イスラエル(ファブ28)の既存の5施設を22nm プロセス製造技術に移行する計画。



インテル® Core™ i5 プロセッサ
(2009年9月)



第2世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー(2011年1月)



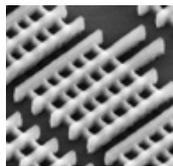
インテル® Xeon® プロセッサ E5
ファミリー(2012年3月)



第3世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー(2012年4月)

2011年5月

マイクロプロセッサの量産技術として、歴史的な革新となる世界初の3次元構造の“トライゲート・トランジスター”を発表。低電圧・低リーク電流のマイクロプロセッサの動作を可能にし、かつてない性能向上と消費電力削減を実現。このトランジスター技術により、小型携帯機器から強力なサーバーまで、幅広い機器において新たな革新を実現する。



薄型軽量ノートブックPCの新カテゴリー「Ultrabook™」を提唱。最新ノートブックPCの性能と機能を備えながら、極めて高い応答性、セキュリティ機能を搭載し、従来のノートブックPCとは一線を画す、魅力的なユーザー体験を実現。



2011年11月

トヨタ自動車株式会社と、車内におけるモバイル機器の接続など、新しい利用モデルを可能にする次世代車載情報通信システム (IVI) の共同研究を開始すると発表。また、2012年4月には、日産自動車から次世代車載情報通信システムにインテルの技術を採用と発表。斬新で革新的なドライブ体験を実現する研究開発で協力。

2012年4月

3次元トライゲート・トランジスター技術採用22nm(ナノメートル)プロセス技術を採用した世界初のプロセッサとなる、第3世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。従来の製品と比較して、3次元グラフィックス性能およびHDメディアの再生処理能力が最大2倍に、マイクロプロセッサ性能が約20%向上し、快適なビジュアル体験を実現。

2012年9月

こどもが主役の街「キッズニア東京」に『サッカー スタジアム』パビリオンを出展。子供たちがスポーツの楽しさを体感するとともに、テクノロジーをより身近に感じられるような実写を含めた迫力ある映像を提供。リアルとバーチャルが織りなす体験を提供し、子供たちの創造力の向上に役立つことを期待。



2012年11月

並列化の世界に「革新」をもたらす新アーキテクチャー、インテル® Xeon Phi™ コプロセッサを発表。

2013年5月

ブライアン・クルザニッチが第6代CEOに就任。データセンターからタブレット/スマートフォン、ウェアラブル・コンピューター、IoTに広がるすべてのコンピューティング市場セグメントでのリーダーシップの確立を指揮。



2013年5月

性能と電力効率の大幅な向上を実現するインテルの22nm プロセス技術に基づく3次元トライゲート・トランジスター技術採用のシステム・オン・チップ (SoC) の新デザイン、Silvermont マイクロアーキテクチャーを発表。

2013年6月

インテル製品のフラッグシップとなる22nm プロセス技術に基づくHaswell(開発コード名)マイクロアーキテクチャーをベースにした第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。PCのパフォーマンスとタブレットの機動性を兼備し、ユーザーのニーズに合わせて利用できる最先端の2 in 1 デバイスを実現。

2013年9月

新たな低消費電力製品、インテル® Quark™ プロセッサ・ファミリーを発表。産業向けのインターネットに接続された機器 (Internet of Things: IoT) からウェアラブル・コンピューティングに至るまで、成長を続ける市場セグメントでのビジネスの拡大を目指す。

2013年9月

Silvermont マイクロアーキテクチャーに基づくタブレット向けマルチコア SoC、Intel Atom® プロセッサ Z3000 製品ファミリー(開発コード名: Bay Trail-T)、マイクロサーバーやコールドストレージなどデータセンター向けのSoC、Intel Atom® プロセッサ C2000 製品ファミリーを発表。

2013年10月

イタリアで開催された Maker Faire Rome で、製作者や教育関連のコミュニティーで広く利用されているオープンソースのハードウェア・プラットフォームを開発する Arduino LLC との連携を発表。インテル® アーキテクチャーを採用した初の Arduino* 互換開発ボード製品となるインテル® Galileo 開発ボードを公開。

2014年1月

世界的なファッション・デザインハウス/キュレーターの Opening Ceremony 社、高級小売店である Barneys New York、アメリカファッション協議会 (CFDA) とともに、スマートなウェアラブル・テクノロジーの提供を目的とした取り組みを発表。この協力に基づき、12月から、ファッション性とウェアラブル端末としての機能の両立させたスマートなプレスレット「MICA (My Intelligent Communications Accessory)」の発売が開始。

人々がテクノロジーをより簡単・自然に、そして現実世界と同じような手法で利用できることを目指し、「インテル® RealSense™ テクノロジー」を披露。同テクノロジー初となるインテル® RealSense™ 3D カメラは、赤外線を利用した深度センサーを備えた世界初の統合型3D カメラです。11月には同3D カメラを搭載した PC が発売開始。



2014年7月

パナソニック株式会社 システム LSI 事業部と、AV 機器市場向けの将来のパナソニックの SoC の製造で契約を締結。インテルのカスタム・ファウンドリー事業部は、低消費電力版 (LP) 14nm プロセスを用いて、将来のパナソニックの SoC を製造。

2014年8月

インテル初となるデスクトップ PC 向け 8 コア プロセッサ「インテル® Core™ i7-5960X プロセッサ エクストリーム・エディション」を発表。16 スレッド同時実行と DDR4 メモリーのサポートにより、コンテンツ制作やゲーム、マルチタスク業務で強力な処理性能を発揮。

2014年9月

ファンレス設計により、超薄型の筐体で性能と長時間のバッテリー駆動、美しさを備えたシステムを可能にする、インテル初の次世代 14nm プロセス技術採用のマイクロプロセッサ「インテル® Core™ M プロセッサ」を発表。

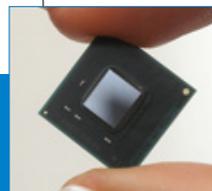
三菱電機と協力し、IoT 向けソリューションとビッグデータの分析を通じて、ファクトリー・オートメーション (FA) システムの進化を加速。製造業向けに、IoT 実証試験を通じて予防保全ソリューションを提供。



Intel Atom® プロセッサ Z2760
(2012年9月)



第4世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー
(2013年6月)



インテル® Quark™ プロセッサ・ファミリー
(2013年9月)



Intel Atom® プロセッサ Z3000
(2013年9月)

2014年2月

ビッグデータを活用し革新的なリアルタイム分析を実現するインテル® Xeon® プロセッサ E7 v2 ファミリーを発表。業界で最大容量のメモリーをサポートし、大量データの高速分析や、膨大なデータから多様な潜在的ニーズのリアルタイム収集を実現。

2014年3月

つくば本社のインテル® コラボレーション・センターを、インテル® ヒューマン・インタラクティブ・テクノロジー・アプリケーション・センターとしてリニューアル。日本のみならず近隣アジアをはじめとする国外の企業とのコラボレーションを通じて、将来のコンピューティングの利用モデルやコンセプトを積極的に発信。



企業によるビッグデータ活用の加速と変革に向けて、Cloudera と協業。また、インテルは、Cloudera への大規模な投資を実施。

2014年5月

日本の自動運転技術の開発企業である ZMP への投資を発表。自動運転や運転支援技術の早期実現に向けた開発を支援。また、未来の自動運転技術の実現に向けた技術革新を加速させるため、ハードウェアとソフトウェアで構成されるインテル® In-Vehicle ソリューションや先進的な技術研究の取り組みを発表。自動車の情報化、優れたアシスト機能や制御機能など、自動車の進化に貢献。

2014年10月

無線機能を内蔵した切手大のコンピューターであるインテル® Edison 開発ボードの国内販売計画を発表。ネット接続された革新的なウェアラブル機器や小型端末を開発する個人や小規模企業の参入障壁を低減し、発明家や起業家、消費者製品のデザイナー、Maker のイノベーションや製品開発の加速化を支援。



2014年11月

進化し続けるデジタルの製品や技術、コンセプトを紹介する「インテル フューチャー・ショーケース 2014」をアジアで最初に日本で開催。ユーザーの利便性を追求することにより登場してきたさまざまな『現在』のデジタル機器から、まもなく生まれるであろう『明日』の技術、さらに将来に向けて開発が進む『未来』の技術やコンセプトを紹介し、将来にわたり進化し続けるデジタルの世界を体験。



2014年12月

IoTの実現に向け、ネットワーク接続性とセキュリティを一体化、簡素化させたエンドツーエンドのリファレンス・モデルとなるインテル® IoT プラットフォームを発表。さらに、この新しいプラットフォームに対応した統合型の各種ハードウェア/ソフトウェア製品、ならびに IoT の導入を現在の初期段階から、本格導入へと進展させるためのシステム・インテグレーターのエコシステムとの新たな連携も発表。

2015年1月

第5世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。インテルの14nm プロセス技術の採用により、前世代との比較で、トランジスター数は35%増、ダイの大きさを37%縮小。また、グラフィックス性能を最大24%向上、動画変換を最大50%高速化。さらに電源管理や設計面での強化によりバッテリー駆動時間を最大1.5時間延長。

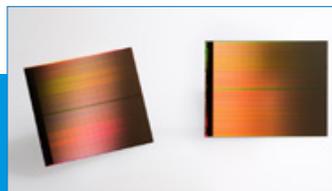
ウェアラブル技術でのイノベーションの創出を目指し、インテル初のウェアラブル機器専用のシステム・オン・チップ (SoC) をベースにした小さなハードウェア製品となるインテル® Curie™ モジュールを公開。加えて、ウェアラブル技術の進展に向け、新たに Luxottica Group のオークリーとウェアラブルでのコラボレーションを発表し、プレミアムなスポーツアイウェアとスマートな技術との融合を図る。



第5世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー (2015年1月)



インテル® Compute Stick (2015年6月)



3D XPoint™ テクノロジー (2015年7月)



第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー (2015年9月)

2015年6月

ポケットに入れて持ち運べるスティック型コンピューター「インテル® Compute Stick」を国内で発売開始。スティック型の本体をTVモニターのHDMI* 端子につなげることで、PCとして活用でき、手軽に旅先や出張先のホテルなどでも、ウェブやメールの閲覧、書類作成、ストリーミング・コンテンツの閲覧など、普段と変わらないコンピューティング体験が可能。

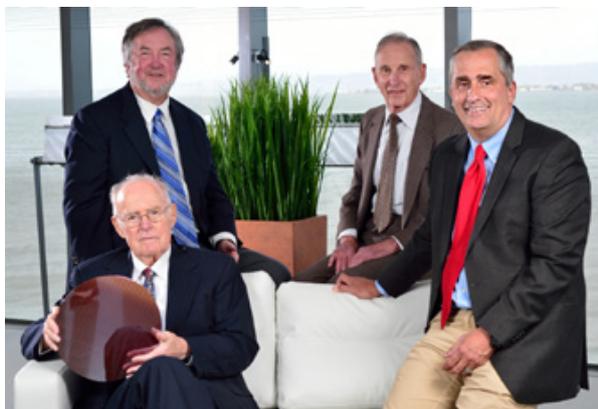
2015年7月

マイクロン テクノロジー社と、不揮発性メモリーの新技术となる3D XPoint™ テクノロジーを公表。1989年のNANDフラッシュメモリーの登場以来となる、画期的な製造プロセス技術により、新しい種類のメモリーを実現。同テクノロジーは、高速なデータアクセスから大規模データの処理に対応し、あらゆるデバイスやアプリケーション、サービスを変革させる可能性を秘める。

株式会社NTTドコモが進める第5世代移動通信方式の実験協力を協力。2020年のサービス提供を目指し、10Gbpsを超える通信速度、LTEの約1,000倍にもおよぶ大容量化、M2M通信の普及に伴う端末数の増加や多様なサービスへの対応の実現を支援。

2015年4月

エレクトロニクス業界の重要なできごとの1つに挙げられる「ムーアの法則」が50周年を迎える。8月には、未来を担う小中学生の技術に対する興味・関心の喚起と向上を目的に、東京・北の丸公園の科学技術館で50周年記念展示を開催。



2015年9月

第6世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。インテルの14nm プロセス技術で製造されたSkylakeマイクロアーキテクチャー(開発コード名)をベースとし、これまで以上に消費電力を低く抑えながらも、パフォーマンスを強化し、より実体験に近いPC体験を提供。

株式会社 東芝と、IoTのセキュリティ・ソリューションで協業。東芝の産業インフラ向けIoTソリューションとインテルのセキュリティ・ソフトウェアを組み合わせ、サイバー攻撃の脅威やデータ漏えいなどのリスクに対応する高度で堅牢なIoTセキュリティ・ソリューションを提供。

2015年10月

LINE株式会社とソフトウェア開発者に向けた技術情報支援とIoT対応ソリューションの導入促進を目的とした連携で合意。この取り組みに基づくソリューションとして、キリンビバレッジパリュウベンダー株式会社が、インテル® プロセッサを搭載したインテリジェント自動販売機を提供すると公表しました。LINE* ビジネスコネクと連携した自動販売機によりユーザーに新たなエンターテインメント体験を提供し、さらに優れた顧客体験を提案。

2015年11月

インテル® IoT プラットフォームの最新技術や、先進のIoT活用を取り組む国内外の企業の事例を紹介するIntel IoT ASIA 2015を開催。会津若松市によるスマートシティへの取り組みや富士通の同社島根工場の取り組み、パナソニックの小売りに対するソリューション、取り組みなどを紹介。

2015年12月

日本でも近年注目を集めている、PC オンラインゲームをスポーツ競技としてとらえるeスポーツ(エレクトロニック・スポーツ)



の楽しさを紹介するイベント「Intel® CLUB EXTREME GAMERS WORLD」を秋葉原で開催。

FPGA(Field Programmable Gate Array)技術で業界をリードするアルテラ コーポレーションの買収を完了。この買収を通じて、インテの製品群を補完すると同時に、高成長を続けているデータセンターやIoT市場での新しいタイプの製品の投入を目指す。

2016年6月

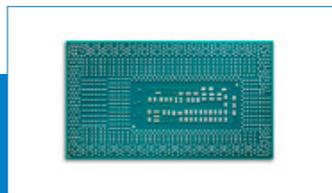
オーストラリアで開催された光、音楽、アイデアの祭典「Vivid Sydney」で、画期的なテクノロジーを駆使し、クリエイターとともに創りだした想像を超えるさまざまなエンターテインメントで観客を魅了。特に、インテルのテクノロジーをベースに音楽に合わせてドローン100機を同時に飛行させる光のショー「Drone 100」は祭典の中で最大の注目を集める。

2016年7月

高度な完全自動運転車向けプラットフォームの構築を目指し、BMW グループ、Mobileyeと提携。自動車、テクノロジー、コンピューター・ビジョン、マシンラーニングの専門知識を組み合わせ2021年の量産、実用化を目指す。2017年には、インテルがMobileyeの買収を発表。両社のテクノロジーを統合し、自動車業界の変革を促す運転ソリューションを提供する計画。

2016年7月

「アクティブ・ラーニング(能動的学習)」「アダプティブ・ラーニング(学びの個別化)」などの新たな教育方法の改善・実現に向けて、株式会社内田洋行と「教育IoT」の実装や検証で協業。ICTやIoTデータを活用した新しい教育プラットフォームづくり、「教育IoT」データ活用による授業改善・新たな教育方法の実現、「教育IoT」データ活用のあるべきシステム環境の検討(データ処理軽減、セキュリティ)、「教育IoT」の実装と実証研究によるエビデンスのとりまとめに着手。



第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー
(2016年8月)

2016年4月

クラウド移行をより簡単、より高速に実現させる要素技術を発表。先進な Software-Defined Clouds (SDC) 基盤を実現するインテル® Xeon® プロセッサ E5-2600 v4 製品ファミリーや、新たに 3D NAND を採用し、高速かつ信頼性の高いデータ・アクセスを実現するインテル® SSD により、クラウド・ソリューションの導入を加速化。

2016年4月

インテル、最新の職場環境を実現する第6世代インテル® Core™ vPro® プロセッサ・ファミリーを発表。2 in 1、Ultrabook™、一体型PCから最新のデスクトップPCに至るさまざまなフォームファクター向けに認証によるセキュリティ、性能の向上、コラボレーションの強化など最新のイノベーションを提供することで、大規模企業に求められるセキュリティや生産性の向上などのニーズに対応。

2016年5月

Computex Taipei 2016で成長の好循環を生み出す取り組みを紹介。数十億台規模に達するネットに接続されるスマートデバイス、豊富なデータを活用した新しいサービス、そしてIoTにより急成長するクラウド・アプリケーションにより、次世代のコンピューティングの波が到来するとし、クラウドと機械学習への注力、PCの継続的な進化、ネット接続される「モノ」の拡大、5G基盤となるネットワークの変革を目指す。

2016年8月

第7世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。インテルの14nmプロセス技術を改良した14nm+の採用により性能向上が図られ、UHD(Ultra High Definition)4Kの映像コンテンツにも対応。

2016年11月

インテル、最先端の人工知能に関する戦略を発表。AI向けとして最も包括的なデータセンター向けAIコンピューティング・ポートフォリオとなるインテル® Nervana™ プラットフォームを発表。スマート・ファクトリーやドローンからスポーツ、不正の検知、自動運転まで、あらゆるモノのAI機能を進展させる広範なテクノロジーを体系化。

2016年11月

シェイクスピア没後400年を迎え、劇団Royal Shakespeare Company(RSC)と劇場公演での特殊効果テクノロジーの活用で協力。シェイクスピアの大作「テンペスト」の冬季公演で、モーション・キャプチャー・テクノロジーを活用して俳優の3Dアバターを舞台上に投影するという新しい演出を楽しめる舞台が披露。

2017年1月

自動車、コネクティビティ、クラウドを連携させる自動車向けソリューションの新たなブランドとしてインテル® GO™ を発表。次世代 Intel Atom® プロセッサやインテル® Xeon® プロセッサという選択肢が用意され、開発者が必要とするパフォーマンスに合わせて拡張が可能な複数の開発キットと、自動運転車に特化した業界初の5G対応開発プラットフォームを提供。この新しいソリューションを通じて、完全自動運転の実現に向けた自動車業界の取り組みを加速させ、市場に新たなユーザー体験を実現。



2017年3月

リテールテック JAPAN 2017で、次世代のショッピング体験を実現するインテルのリテール向けテクノロジーを展示。また、パートナー企業との共同展示を通じて、店舗解析、POS、デジタルサイネージやバーチャル試着など、デモンストレーションを通して紹介。

2017年3月

Intel Technology and Manufacturing Dayを開催し、近い将来においてムーアの法則が終焉を迎えることはないとし、業界とテクノロジーのリーダーシップを発揮していくとの姿勢を示す。また、ファウンドリー向けの新しい超低消費電力22nm FinFET プロセスや、第3世代のFinFET テクノロジーを採用した10nm プロセスの情報を開示。

2017年4月

東京でインテル AI Dayを開催し、人工知能(AI) に分野に関するインテルの最新の取り組みを紹介。AIアプリケーションをあらゆる業界で仮想的に構築するためのエンドツーエンドのハードウェアやソフトウェアの提供、AI事業への継続的な投資に加え、顧客、研究者、開発者とのパートナーシップを通じて、この“AI コンピューティング時代”をリードする企業として、すべての人々がAIを活用できる時代の構築を目指す。

2017年1月

CES 2017で、自動運転車や5Gで業界をけん引するリーダーとして、また、仮想現実(VR)や、さらに進んだマージド・リアリティの革新における中心的存在としての役割を果たすためのさまざまな技術を発表。次世代CPU(開発コード名: Cannon Lake)を搭載した最初のデバイスとなる2 in 1 PCの披露に加え、インテルのVR技術であるVOKE VRをOculus Riftに搭載する計画など、インテルは、より素晴らしいユーザー体験の実現に向けて、テクノロジーの限界をさらに押し上げるための取り組みを紹介。



2017年2月

レディー・ガガ、Pepsi社、NFLと協力し、Pepsi Zero Sugar* Super Bowl LI ハーフタイム・ショーで披露したインテル® Shooting Star™ ドローンのフライトが観客を魅了。

2017年4月

関西電力ほか、クラウドおよびハードウェア事業協力社の協力のもと、世界標準のIoTプラットフォームを採用した家庭向け宅内IoTプラットフォームの実証実験を開始。家庭で収集されたデータを活用した新規サービスを通じて経済活動の向上や、より快適な生活の実現を目指す。

2017年5月

インテルのSilicon Valley Innovation Center内に、自動運転技術の実現に向けたAutonomous Driving Garageを開設。オーニング時に開催されたワークショップには、BMW



やDelphi、Ericsson、HEREも参加し、進行中の自動運転の研究開発の紹介に加えレベル4の自動運転車での公道走行も実施。

2017年6月

これまでのインテル製品の中で最も拡張性に優れ、入手しやすさと高性能を備えたプラットフォームとなるインテル® Core™ Xシリーズ・プロセッサ製品ファミリーを発表。業界最高の性能を提供し、仮想現実向けのコンテンツ制作やデータのビジュアル化などのデータ要件の厳しいタスクを根本的に変革。

2017年6月

国際オリンピック委員会(IOC)と長期的なテクノロジー・パートナーシップを発表。ワールドワイド・スポンサーシップ・プログラムの「TOP (The Olympic Partner)」に加わり、2024年までワールドワイドTOPを務め、最先端の技術を用いたファンとの新次元の交流を実現したオリンピック大会の未来を描く。



2017年8月

株式会社デンソー、トヨタ自動車株式会社、株式会社トヨタIT開発センター、日本電信電話株式会社、株式会社NTTドコモとともに Automotive Edge Computing Consortium (オートモーティブ・エッジ・コンピューティング・コンソーシアム) の創設に向けた活動を開始。インテリジェントな車両制御、リアルタイムデータを用いた地図生成、クラウド・コンピューティングによる運転支援など、今後、コネクテッド・カーの実現に向け必要となる様々なサービスを支える基盤づくりを推進。

2017年8月

第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーの提供を開始。最初の製品となるモバイル向け第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーは、性能が前世代のプロセッサとの比較で最大40%、5年前に発売されたシステムでの比較では2倍に向上。今だけでなく、未来でも楽しめるコンピューティング体験の実現を目指す。



インテル® Core™ Xシリーズ・プロセッサ・ファミリー (2017年6月)



インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (2017年7月)



モバイル向け第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリー (2017年8月)

2017年7月

データセンター・プラットフォーム向けに 業界最高水準の性能と豊富な機能を提供するインテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサを発表しました。リアルタイム分析や仮想化インフラの構築、ハイパフォーマンス・コンピューティングなど演算処理能力が必要なタスクにおいて、かつてないほどの性能向上を実現し、この10年で最大規模となるプラットフォームの進化を実現するデータセンター / ネットワーク向けプロセッサ。

2017年7月

エネルギー企業および関連サービス事業者に向け、国内でのIoTプラットフォーム「エネルギー・コレクティブ・プラットフォーム」の構築に向けた取り組みを開始。IoT、AIの革新的な技術を備えるプラットフォームを提供し、電力会社、家庭およびサービス事業者による新しい価値の創出を支援。

2017年7月

ハウステンボス株式会社、株式会社 hapi-robot とともに、長崎のハウステンボスで、インテル® Shooting Star™ ドローン・ライトショーを日本で初めて開催。300機の機体が音楽に合わせて、様々なシーンや3Dアニメーションで飛行する最先端のショーで観客を魅了。



2017年9月

特許庁が、インテルのサウンドロゴを音楽的要素のみからなる音商標として登録。「イノベーションを起こす企業」としてのブランディング活動とそれに伴う社会への寄与に取り組んできた成果となる顕著な出来事。

2017年11月

NTTドコモ、トヨタ自動車、エリクソンと、自動車における5Gの活用に向けた実証実験を東京臨海副都心地区で開始。小型車載アンテナを用いて、複数の5G基地局に跨る走行実験に成功したことにより、2020年の5G商用環境に近い状況でのコネクテッド・カーの実現可能性を立証。

2018年1月

CES 2018で、自動運転から人工知能(AI)、仮想現実(VR)、そして没入感のあるさまざまなメディアにまで広がるデータを駆使したさまざまなイノベーションを紹介。自動運転分野では、BMW、日産、フォルクスワーゲンの車両計200万台がMobileyeのRoad Experience Management (REM) 技術を利用して、データをクラウドソースすることで、低コストながら拡張性のある高解像度地図を今年中に構築し、その更新も進めていくと発表。また、自動車向けのIntel Atom® プロセッサとMobileye EyeQ5® チップを組み合わせ、レベル3～5の自動運転を可能にする業界トップクラスの拡張性と多用途性を備えた新しい自動運転プラットフォームの詳細を公開。



2018年4月

デル株式会社とともに、高知県須崎市の地域活性化を目指して連携すると発表。両社は、タブレット機能を備えたパソコン「2in1」やテレビ会議システムの提供などで働き方改革の推進やICT教育への注力、さらには、ITによる町おこしを進めている須崎市を支援。須崎市は、これらを活用して、2015年に策定した地域活性化計画「すさきがすきさ産業振興計画」の目標達成を目指す。

2018年4月

ノートブックPC向け第8世代Intel® Core™ i9 プロセッサが登場。最上位となるIntel® Core™ i9-8950HK プロセッサはモバイル向けとしては初の6コア/12スレッドのプロセッサであるとともに、アンロックに対応し、新たに搭載されるIntel® サーマル・ペロシティー・ブースト (Intel® TVB) を活用することで最大200MHzにまで向上が可能。



第8世代Intel® Core™ プロセッサ・ファミリー (2018年4月)

2018年6月

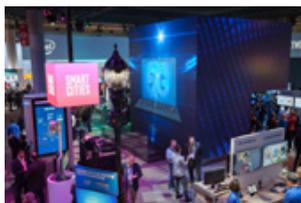
8086 プロセッサの登場から40周年、Intel創立50周年を記念し、Intel史上最高のデスクトップ用ゲーミング性能を備えた限定版の第8世代Intel® Core™ i7-8086K プロセッサの提供開始を発表。同時にPCの未来に向けたIntelのビジョンを共有するとともに、Intelと幅広いエコシステムがこの未来を実現できるよう支援するさまざまな最新テクノロジーも発表。今日のニーズに対応し、人々が自身にとって最も重要なことに取り組めるようサポートするために、パフォーマンス、コネクティビティ、バッテリー稼働時間、順応性、インテリジェンスという5つの要素から新たにPCのイノベーションを起こす必要性を説明。

2018年6月

Intel インダストリアル IoT ソリューション DAY を都内で開催し、エッジ・コンピューティングを中心に、AI/ディープラーニング、マシンビジョン、データ分析など、さまざまな角度から製造業向けの最新のIoTソリューションを紹介。

2018年2月

MWC 2018で、NTTドコモと協業し、東京2020オリンピック競技大会向けに5Gテクノロジーを提供することを発表。また、5Gのネットワーク・エッジに必要なコンピューティング/ネットワーク/ストレージの大容量ワークロードに対応できる消費電力効率に優れた性能を実現するシステム・オン・チップ(SOC)、Intel® Xeon® D-2100 プロセッサを含む、Intelのアーキテクチャーを基盤とした革新的なソリューションを紹介。



2018年2月

2018年平昌オリンピック冬季競技大会開会式で、1,218機のIntel® Shooting Star™ ドローンが夜空を彩り、ドローンの最多同時飛行としてギネス世界記録*を樹立。また、2018年平昌オリンピック冬季競技大会のナショナルパートナーであるKTと協力し、冬季オリンピックとしては初となる、Intelの5Gテクノロジーを活用した大規模な5Gネットワークを提供。



2018年5月

Intelや業界各社のテクノロジーを活用し、IoTやAI、VRなど、最新のコンピューティング技術の利用モデルやコンセプトを紹介し、そのビジネスのさらなる成長を促進するとともに、新規ビジネスの創出を目的とした「Intel® コラボレーション・センター」を東京オフィス内に開設。



2018年5月

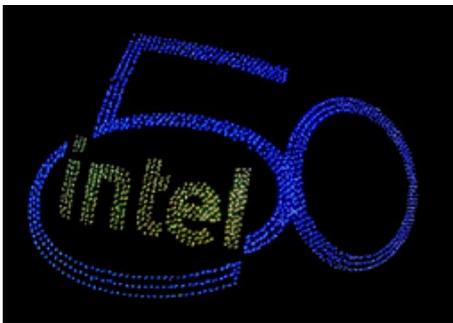
AI関連の開発者向けイベント「AI DevCon」を初開催し、IntelのAI向けポートフォリオやIntel® Nervana™ ニューラル・ネットワーク・プロセッサのアップデートを紹介。また、Intelがオリンピック競技大会の公式AIプラットフォーム・パートナーとなり、開発者コミュニティから、オリンピック競技大会という世界最大規模のスポーツの祭典でAIを活用するためのアイデアを募集する「Intel® AI Challenge for the Olympic Games」を新たに開催すると発表。

2018年7月

インテル エネルギーフォーラム 2018を開催し、日本を代表するエネルギー関連企業や専門家によるセッション、海外での先行事例などの紹介を通じて、エネルギー業界でのデータ活用の展望や、家庭・地域向けサービスの在り方を提言。

2018年7月

2018年7月18日に創立50周年を迎える。創立50周年を記念し、米国カリフォルニア州フォルサムに本社施設の上空に2,018機のインテル® Shooting Star™ ドローンを飛行させ、無人航空機による最多同時飛行で新たなギネス世界記録*を樹立。インテルが50年前に創立されて以降持ち続けている革新を実現していくという精神を証明。



2018年9月

米国でIntel 5G Summitを開催。メディア、通信事業者、ネットワーク機器ベンダーといったパートナーとともに、メディアにおける5Gを活用した最新の取り組み事例などを紹介。

2018年9月

データセンター/クラウド・コンピューティング、IoT、AI、通信機器、産業機器、車載機器など幅広い分野での採用が広がるインテル® FPGA 関連製品およびソリューションの最新情報を、20のカンファレンス、43台のデモなどを通じて紹介するインテル® FPGA テクノロジー・デイ2018を開催。

2018年8月

米国でData-Centric Innovation Summitを開催し、データを中心としたコンピューティングの未来に向けたインテルの戦略や市場機会に関する見解を紹介。また、インテル® Xeon® プロセッサの次世代ロードマップを公開し、次世代製品の「Cascade Lake (開発コード名)」では、不揮発性メモリ「インテル® Optane™ パーシステント・メモリ」の実装やAIアプリケーションの学習処理を加速する「ディープラーニング・ブースト」の搭載など、AIアプリケーションの学習と推論のパフォーマンスを向上させるための今後の取り組みも提示。インテル® Arria® 10 FPGAをベースに、インテル® Xeon® プロセッサ搭載システムのパフォーマンスを最適化することができるSmartNIC 製品ライン (開発コード名: Cascade Glacier) により、インテルのコネクティビティー向け製品ポートフォリオをさらに拡張することを発表。

2018年8月

第8世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーとして、薄型・軽量ノートブックPCや2 in 1 向けに最適化された接続性を備え、同時に優れたパフォーマンスと長時間バッテリー駆動を実現したインテル® Core™ プロセッサ・ファミリーUシリーズおよびインテル® Core™ プロセッサ・ファミリーYシリーズを発表。洗練されたコンパクトなフォームファクターながら長時間の駆動が可能という革新的な設計を実現。

2018年8月

小学校の学習指導要領が改定され、「プログラミング教育」の必修化される2020年度に向けて、埼玉、名古屋、京都の大型ショッピング・モール内で、プログラミング・ツール「micro:bit (マイクロビット)」を活用した子供向けプログラミング体験イベント「最新パソコンで楽しもう! 親子プログラミング体験イベント」を開催し、延べ900人ほどの親子が参加。

2018年10月

PCにおける最新のイノベーションから、コンピューター・ビジョンのデモやエンドツーエンドのソリューションをご紹介する「インテル テクノロジー・ショーケース」を開催。インテル最高のゲーミング・プロセッサとなるインテル® Core™ i9-9900K プロセッサなど、デスクトップ向け第9世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。

2018年10月

ソフトウェア開発者やITエンジニアを対象とした「インテル® デベロッパー・カンファレンス 2018」を都内で開催し、HPC、機械学習、ディープラーニング、データセンター、ロボティクス、ゲーム、IoTなどの分野におけるインテルの最新技術や導入事例、ソフトウェア開発手法を紹介。

2018年11月

インテル株式会社の代表取締役社長に、ソニー株式会社などの役員を歴任し、エレクトロニクス業界の広範な事業分野において豊富な経営経験を有する鈴木 国正が就任。



2018年12月

Architecture Dayを開催し、新しいCPUのマイクロアーキテクチャーの開発コード名が「Sunny Cove」であることを明らかにするとともに、3次元パッケージング技術「Foveros」、コンピューティング・エンジン全体にわたるプログラミングをシンプルにする「oneAPI」ソフトウェアなど、インテルが開発している次世代CPUなどに採用される各種技術を公開。



2019年2月

2016年からCFOを、2018年6月から暫定CEOを務めていたロバート（ボブ）スワンが、インテル7代目のCEOに就任。



2019年2月

楽天が進める完全仮想化によるエンドツーエンドのクラウド・ネイティブ・モバイル・ネットワークに、インテル® Xeon® プロセッサおよびインテル® FPGA ベースのアクセラレーターが採用されたことを発表。

2019年2月

MWC 2019において、Ericssonの5G基地局向け製品ラインナップの主要なコンポーネントに10nmプロセスのSoC「Snow Ridge」の採用、5G RANからコア・ネットワーク・アプリケーションに至る仮想化ネットワークの機能を高速化するために特別に設計された新しいインテル® FPGA PAC N3000の発表など、5Gによる革新を加速する新製品やパートナーとの協業を発表。



インテル® FPGA PAC N3000 (2019年3月)

2019年1月

CES 2019において、10nmプロセスで初めて量産されるインテルのPC向け次期プロセッサ「Ice Lake (開発コード名)」を搭載した統合プラットフォームの紹介や、3次元パッケージング技術「Foveros」の採用によるハイブリッド型の10nmで製造されるCPUアーキテクチャー「Lakefield (開発コード名)」のプレビュー、また5GやAIなど次世代の技術に対応したPC体験を提供する先進的なモバイルPCの実現を支援する革新的なプログラム「Project Athena」など、数々の新しいPCイノベーションを公開。また、インテルとAlibabaによる、史上初となるAIを活用した3Dアスリート・



トラッキング技術の開発のパートナーシップを発表など、AIや5G、自動運転などの成長領域に関するさまざまな発表も行い、新しいユーザー体験や将来のフォームファクターの実現に求められるデータセンター、クラウド、ネットワーク、エッジ・コンピューティングにおけるイノベーションを紹介。

2019年3月

NFV市場向け新製品として、MWC 2019で紹介されたインテル® FPGA PAC N3000を国内で正式発表。

2019年3月

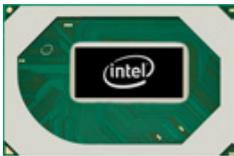
物流業界向けのIoTソリューションとして、サプライチェーンにおける荷物の輸送状況をリアルタイムで分析・可視化する「インテル® コネクテッド・ロジスティクス・プラットフォーム (インテル® CLP)」を国内で本格展開すると発表。インテル® CLPを活用することで、デジタル・トランスフォーメーションを支援。

2019年4月

インテリジェント・エッジからクラウド、人工知能(AI)、5Gに広がる高いコンピューティング能力を必要とする処理に最適化された第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ、大量のデータに対応するインテル® Optane™ パーシステント・メモリーおよびストレージ・ソリューション、データ中心の時代に向けた柔軟なハードウェア・アクセラレーションとなる新しい10nmプロセスによるインテル® Agilex™ FPGAなど、データの移動、保存、処理に向けた広範な製品ポートフォリオを発表。

2019年4月

デスクトップ級のパフォーマンスをモバイル筐体で実現するとともに、最速かつ最も信頼性の高いワイヤレス機能であるインテル® Wi-Fi 6 AX200 (Gig+) や最も汎用性の高い有線接続であるThunderbolt™ 3 テクノロジーを搭載するなど、ノートブックPCの性能をさらに向上させたいゲーマーやクリエイター向けに設計された、史上最も高性能な最新の第9世代インテル® Core™ モバイル・プロセッサ・ファミリーHシリーズを発表



第9世代インテル® Core™ モバイル・プロセッサ・ファミリーHシリーズ (2019年4月)

2019年8月

ノートブックPCに対するニーズや課題、期待を理解するための長年の研究に基づくプログラム「Project Athena (開発コード名)」によって認証されたノートブックPC向けの認証マーク「Engineered for Mobile Performance」を発表。PCメーカーや小売企業は、この認証マークを使用して、本プログラムで設定されている目標仕様や主要体験指標(KEI)を満たすノートブックPCを店頭やオンライン上でのプロモーションが可能。



Engineered for Mobile Performance (2019年8月)

2019年5月

COMPUTEX 2019で、モバイル・コンピューティングを新しいレベルに導く第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーを発表。インテルの10nmプロセス技術、新しい「Sunny Cove(開発コード名)」コア・アーキテクチャー、新しいGen11(第11世代)のグラフィックス・エンジンを採用し、最大4コア/8スレッド、最大4.10GHzのターボ周波数、最大1.10GHzのグラフィック周波数を提供するインテル® Core™ i3 プロセッサからインテル® Core™ i7 プロセッサで構成。システムメーカーに、最新かつ最上位レベルの規格と世界最高クラスの性能だけでなく、チップサイズの削減による筐体デザインや美しさの革新性追求の自由度も提供。



2019年9月

画期的なテクノロジーを活用する東京2020オリンピック競技大会の未来に向けて、国際オリンピック委員会(IOC)、東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会(Tokyo 2020)ならびに広範なパートナーと協力していくことを発表。5Gプラットフォームから人工知能(AI)ソリューション、そしてeスポーツや没入感のあるメディアに至るさまざまなイノベーションを通じて、東京2020オリンピック競技大会で「コンピューティング」「コネクト(ネットワーク接続)」「エクスペリエンス(体験)」の3つの重点分野に取り組む。



2019年10月

PCにおける最新のイノベーションを紹介する「インテル テクノロジー・ショーケース」を東京・秋葉原で開催。第10世代インテル® Core™ プロセッサ・ファミリーによる新たなPC体験のほか、数々の最新テクノロジーを紹介。

2019年10月

すべてのコアを最大5GHzのターボ周波数で動作させ、究極のゲーム体験を実現する第9世代インテル® Core™ i9-9900KS プロセッサ・スペシャル・エディションを販売開始。より多くのコアを使用して実行することで高いフレームレートを実現し、より高速なゲーム環境を実現。



インテル® Core™ i9-9900KS プロセッサ・スペシャル・エディション (2019年10月)

2020年1月

CES 2020において、自動運転への道を拓く人工知能における進展やモバイル・コンピューティング・イノベーションの新時代、没入感の高いスポーツやエンターテインメントの未来などについてデモを実施。インテルがどのようにしてクラウドやネットワーク、エッジ、PCにまたがってインテリジェンスを導入し、社会やビジネス、私たちの日々の生活にポジティブな影響を与えているかを説明。あわせて、最新のインテル® Core™ モバイル・プロセッサ・ファミリー(開発コード名: Tiger Lake)とXeアーキテクチャーをベースにした初のディスクリット型 GPU を披露。

2020年2月

5G ネットワークの初期展開で重要となる無線基地局向けの10nm ベース・システム・オン・チップ (SoC)、Intel Atom® プロセッサ P シリーズや新しい第2世代インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ、5G ネットワークを加速させるインテル初の次世代ストラクチャード ASIC (開発コード名: Diamond Mesa) など、ハードウェアからソフトウェアに至る広範なポートフォリオを発表。5Gの可能性を最大限に引き出すためには、コアからエッジに至るネットワーク・インフラストラクチャーの変革が求められ、インテルは、世界をリードするネットワーク・シリコン・プロバイダーとして、この変革を最前線で推進。



第2世代 インテル® Xeon® スケーラブル・プロセッサ (2020年2月)

2019年10月

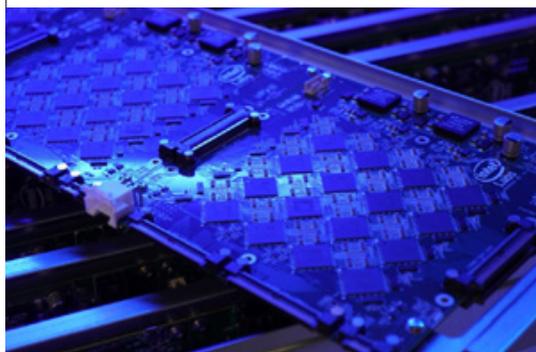
人々の生活や人と技術の関係を劇的に変え、あらゆるものがつながるスマートな世界の実現を目指し、日本電信電話株式会社、ソニー株式会社とともに、新たな業界フォーラムである Innovative Optical and Wireless Network (IOWN*) Global Forum を設立。オールフォトニクス・ネットワーク、エッジ・コンピューティング、無線分散コンピューティングから構成される新たなコミュニケーション基盤の実現を促進。

2019年11月

インテルの子会社で、先進運転支援システム (ADAS) をリードするモビルアイが、今後の成長に向けた事業戦略を発表。これまでのADAS事業の成功を基に、データを基にした収益機会の獲得や新興のロボタクシー市場への進出など、新たな取り組みを通じて、今後の成長を見込む。

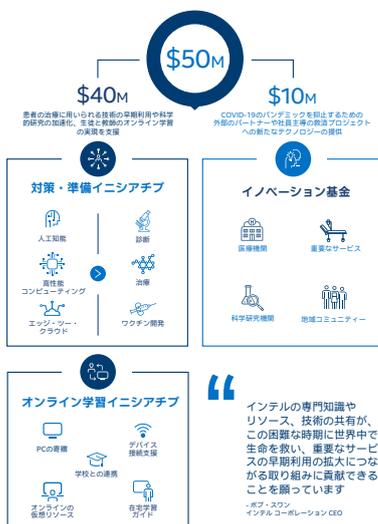
2020年3月

1億ニューロンの演算能力を備えた最新かつ最もパワフルなニューロモルフィック・リサーチ・システム「Pohoiki Springs」を発表。Intel Neuromorphic Research Community (INRC) のメンバーはクラウド経由でこのシステムを利用でき、より大規模かつ複雑な問題の解決を実現。Pohoiki Springs は、インテル史上最大規模のニューロモルフィック・コンピューティング・システムで、標準的サーバー5台分のサイズのシャーシ内に、768基のLoihiニューロモルフィック・リサーチ・チップを搭載。



2020年3月

新型コロナウイルス感染症 (COVID-19) のパンデミック (世界的大流行) を阻止するために、インテルは技術と専門知識を活用し、COVID-19 に対する理解の深耕とより良い有効手段の実現に努める。レノボと BGI ゲノミクスと協力し、COVID-19 の遺伝子特性の解析を加速。BGI のシーケンシング・ツールの機能をさらに強化させ、科学者によるウイルスの感染パターンへの調査や、より良い診断方法の確立を支援。



2020年4月

「新型コロナウイルス (COVID-19) の感染拡大防止に向けた取り組みとして、地域コミュニティ支援の 1,000 万ドルの寄付に続き、技術への取り組みとして新たに 5,000 万ドルを拠出。また、この発表の 100 日後にあたる 7 月には、COVID-19 の感染拡大防止に向けた活動を紹介。



第 10 世代インテル® Core™ モバイル・プロセッサー・ファミリー H シリーズ (2020年4月)



第 10 世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー・ファミリー (2020年5月)

2020年5月

年次の CSR 報告書 (Corporate Responsibility Report) を発表し、企業責任の透明性確保に向けた長年の取り組みに加え、温室効果ガスの排出量の削減など、インテルがこの 10 年間に行ってきた重要な取り組みの進捗を詳報。同時に健康と安全、テクノロジー業界でのインクルージョン、カーボン・ニュートラル・コンピューティングの実現に向けた業界全体の協働を目指すことも説明。また、2030 年に向けた企業責任としての方向性として RESPONSIBLE (社会的責任)、INCLUSIVE (受容性)、SUSTAINABLE (持続可能性)、ENABLING (実現能力) に取り組む RISE 戦略も発表。

2020年5月

ノートブック PC およびデスクトップ PC 向けの新しい第 10 世代インテル® Core™ vPro® プロセッサー・ファミリーを発表。リモートで働く従業員が増える中、次世代のビジネス・コンピューティングの革新を強化するために開発。生産性、接続性、セキュリティ機能およびリモート管理機能の向上を実現。

2020年4月

ノートブック PC 向けとして動作周波数 5GHz の限界を超える第 10 世代インテル® Core™ モバイル・プロセッサー・ファミリー H シリーズを発表。第 10 世代インテル® Core™ i9-10980HK プロセッサーを筆頭とする H シリーズにより、ゲーマーやクリエイターがデスクトップ PC に匹敵するパフォーマンスをどこでも利用可能。

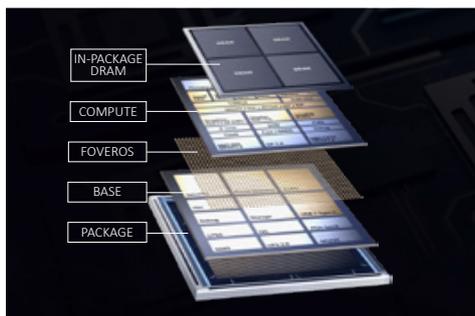
2020年4月

インテルのフラッグシップ製品となる世界最速のゲーミング・プロセッサー、インテル® Core™ i9-10900K プロセッサーなど、第 10 世代インテル® Core™ デスクトップ・プロセッサー・ファミリー S シリーズを発表。第 10 世代インテル® Core™ デスクトップ・プロセッサー・ファミリー S シリーズは、インテル® サーマル・ペロシティー・ブーストの搭載により、5.30GHz の最大動作周波数を実現し、新次元のゲーム体験を可能にするパフォーマンスを実体験で提供。



2020年6月

インテル® ハイブリッド・テクノロジーを搭載したインテル® Core™ プロセッサー・ファミリー (開発コード名: Lakefield) を発表。インテルの Foveros 3D パッケージング・テクノロジーを採用し、省電力性とパフォーマンスを向上するハイブリッド CPU アーキテクチャーを採用した Lakefield プロセッサーは、超軽量かつ革新的なフォームファクターの PC において、優れた生産性とコンテンツ制作体験を実現する、インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー・クラスのパフォーマンスと Windows* との完全互換性を提供する、最小のプロセッサー。



2020年7月

WILLER株式会社とモービルアイが、日本・台湾およびASEANにおけるロボタクシー・ソリューションを提供するための戦略的パートナーシップを発表。モービルアイの自動運転技術を用いた実証実験からサービス展開までを目指す。

2020年8月

Architecture Day 2020を開催し、インテリジェント時代に向けた新しいアーキテクチャーと革新を紹介。最先端のプロセス技術を用いた設計、画期的なメモリー階層、高度なパッケージング技術によるシステムへの統合、光速の相互接続リンクを備えたハイパースケールな展開、単一のソフトウェア抽象化による統一、ベンチマーク定義によるセキュリティー機能など、インテルが保有するスカラー、ベクトル、マトリックス、空間アーキテクチャーの多様な組み合わせにより、大きな進歩を遂げた「技術革新における6つの柱」の進捗状況を公開。



第11世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー
(2020年9月)

2020年9月

2006年以来14年ぶりに企業ロゴを刷新。新しいロゴは、インテルの以前のロゴにインスパイアされ、最も強力なデザイン要素を前面に押し出すと同時に、簡素化かつ近代化し、インテルが進んでいく変革の道を示す。



2020年9月

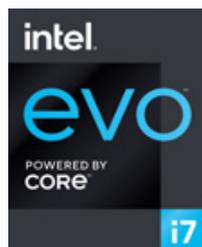
インテル PC FES 2020の開催 最新の第11世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーによる新たな世界を、Business、Creative、Gaming、Music、Programming などさまざまなカテゴリとのコラボレーション・コンテンツを通じてユーザーへ届ける、オンライン・イベント・プラットフォーム「インテル PC FES 2020」を開催。

2020年9月

第11世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリーを発表。インテル® Iris® Xe グラフィックスを搭載した薄型軽量ノートPC向けの世界最高クラスのプロセッサーとして、競合製品と比べて実環境のワークフローにおいて、コンテンツ作成が最大7倍高速に、オフィス生産性が20%以上高速に、ゲーム・ストリーミングでは2倍以上の高速化を実現。同プロセッサー・ファミリーを搭載し、Project Athena イノベーション・プログラムの第2版の仕様と重要体験指標 (KEIs) に準拠したノートPC向けのインテル® Evo® プラットフォーム・ブランドも登場。

2020年9月

IoT向け機能強化された第11世代インテル® Core™ プロセッサー・ファミリー、Intel Atom® x6000E シリーズ、インテル® Pentium® プロセッサーおよびインテル® Celeron® プロセッサー N/J シリーズを発表。新たなAIやセキュリティー機能、機能安全性、リアルタイム性能をエッジ端末に搭載。

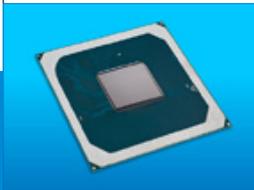


2020年11月

ハードウェアおよびソフトウェアの統合型設計アプローチの一環として oneAPI ツールキットの Gold 版を提供開始。また、データセンター向けとして初のディスクリット・グラフィックス・プロセッシング・ユニット (GPU) となる X^e-LP マイクロアーキテクチャーをベースにしたインテル® サーバー GPU を発表し、急成長するクラウドゲームやメディア・ストリーミング分野に注力。

2020年11月

インテル® eASIC™ N5X デバイスの発表 5G、AI、クラウド & エッジの幅広いワークロードにわたり、アプリケーションのパフォーマンスを高速化するカスタマイズ可能な最新ソリューションとなるインテル® eASIC™ N5X デバイスを発表。



インテル® サーバー GPU
(2020年11月)



インテル® eASIC™ N5X デバイス
(2020年11月)

2020年12月

Intel Labs Day を開催し、第2世代の極低温量子制御チップ「Horse Ridge II」を発表。第1世代 Horse Ridge のコントローラーの革新を基に、強化された機能と、より高度な統合による量子システムの円滑な制御を実現。新機能には、量子ビットの状態を操作して読み取る機能や、複数の量子ビットを重ね合わせる際に必要な複数のゲートの電位を制御する機能を含む。



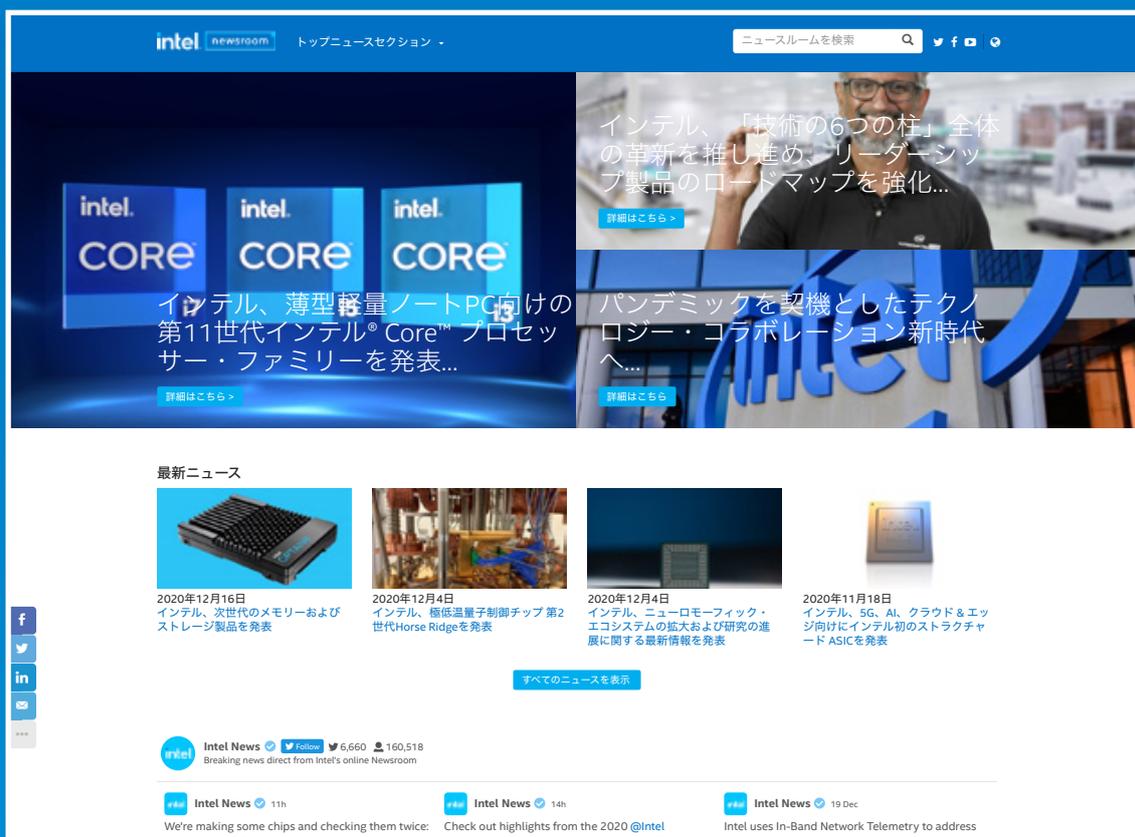
2020年12月

世界最速のデータセンター向け SSD となるインテル® Optane™ SSD P5800X と、パフォーマンスとメインストリームの生産性を兼ね備えたクライアント向けインテル® Optane™ メモリー H20 を発表。また、第3世代のインテル® Optane™ パーシステント・メモリー (開発コード名: Crow Pass) をクラウドおよびエンタープライズ向けに提供することも発表。

Intel Newsroomの紹介

<https://newsroom.intel.co.jp/>

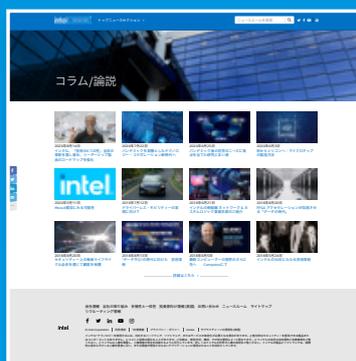
インテルは、「イノベーションを起こす企業」として、コンピューティングのみならず、AIや自動運転、5G、IoTなど、未来を創造するさまざまなテクノロジーの実現に取り組んでいます。Intel Newsroomでは、そんなインテルの最新技術や国内外での活動などを紹介しています。



トップ・ニュース・セクション



ニュースリリース



コラム / 論説



ニュースバイト

*この資料は、2021年1月までの情報をもとに作成されています。

Intel、インテル、Intel ロゴ、Intel Inside、Intel Inside ロゴ、Intel Atom、Intel Core、Core Inside、Intel vPro、Centrino、Celeron、Itanium、Pentium、Xeon、Intel Xeon Phi、3D XPoint、Arria、Curie、eASIC、Intel386、Intel486、Intel Agilex、Intel Evo、Intel GO、Intel Nervana、Intel Optane、Intel Shooting Star、Intel StrataFlash、Iris、MMX、ProShare、Quark、RealSense、Thunderbolt、Ultrabook は、アメリカ合衆国および/またはその他の国における Intel Corporation またはその子会社の商標です。

* その他の社名、製品名などは、一般に各社の表示、商標または登録商標です。

インテル株式会社

〒100-0005 東京都千代田区丸の内 3-1-1

<http://www.intel.co.jp/>

©2021 Intel Corporation. 無断での引用、転載を禁じます。
2021年

310975-018JA

